

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム (SenTePack)

第1回総会・研究会 プログラム

- 1、開催日時：2026年6月19日(金) 13:00~16:55
- 2、開催方式：会場/Online (ハイブリッド開催)
- 3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11階 第1会議室
- 4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>
- 5、プログラム：
 - 13:00~13:30 総会
 - 13:30~13:35 研究会開会挨拶 SenTePack 会長 植村 聖
 - 13:40~14:20 今年度 WG 活動計画
 - ・センシング材料 WG
 - ・環境モニタリング技術 WG
 - ・人・機械インタラクション WG
 - ・半導体製造センシング・実装技術 WG
 - 14:20~15:20
講演1「AI x ROBOT の現状 (仮題)」
サイエンスライター 森山 和道 様
 - 15:20~15:50 コーヒーブレイク (名刺交換・意見交換)
 - 15:50~16:50
講演2「生体センシングの研究開発動向 (仮題)」
横浜国立大学 准教授 杉本 千佳 様
 - 16:50~16:55 研究会閉会挨拶 SenTePack 副会長 山下 健一

お問い合わせ先：

SenTePack 事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail：M-SenTePack-ml@aist.go.jp